

Aperçu de la nouvelle version

### Points clés



#### Les avantages sur la compétition ...

- Analyses QED des circuits avec contre-perçages
- Entrée de données CAO Altium (NEW!)
- Entrée de données DPMX (IPC-2581) (NEW!)
- Formatage conditionnel des valeurs QED basé sur les épaisseurs de cuivre.
- Et plus!

### **QED Contre-perçage**



# Analyses QED des circuits avec contre-perçages (Backdrilled)

- Entrée entièrement automatique des circuits contre-percés
- Analyse QED complète spécifique au contre-perçage

(Nouvelle option)

INITIAL	FORMAT	RENAMED	FUNCTION
7770_Non_Switch_081015-bd-1-4.drl	excellon2	drl_1_4	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-1-6.drl	excellon2	drl_1_6	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-1-8.drl	excellon2	drl_1_8	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-10.drl	excellon2	drl_10_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-12.drl	excellon2	drl_12_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-15.drl	excellon2	drl_15_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-17.drl	excellon2	drl_17_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-19.drl	excellon2	drl_19_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-21.drl	excellon2	drl_21_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-7.drl	excellon2	drl_7_24	backdrill
7770_Non_Switch_081015-bd-24-8.drl	excellon2	drl_8_24	backdrill

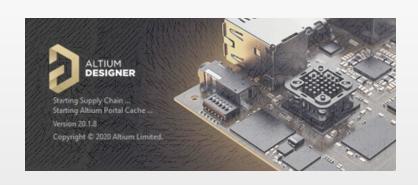
### Entrée de données



#### Entrée de données CAO Altium

- Integre le logiciel Altium Designer pour lire automatiquement les fichiers natifs .pcbdoc d'Altium
- Soyez le premier à proposer une offre !

(Nouvelle option)



### Entrée de données



#### Entrée de données DPMX (IPC-2581)

- Acceptez les données du standard émergent DPMX.
- Augmentez vos parts de marché en acceptant le format préféré de vos clients

(Nouvelle option)



### Formatage conditionnel QED



#### Basé sur les épaisseurs de cuivre

Les cellules colorées en rouge sur le rapport
 QED PDF donne plus d'information quand
 elles sont liées à l'épaisseur de cuivre.

(Ajout au rapport QED PDF)

```
61
       Example:
62
        <FormattingRule id="minimumtrack">
63
          <Condition>lessthan</Condition>
64
          <Value1>0.075</Value1>
65
         <ThicknessRule id="base">
66
            <Condition>lessthan</Condition>
67
            <Value1>0.035</Value1>
68
         </ThicknessRule>
69
        </FormattingRule>
70
        <FormattingRule id="minimumtrack">
71
          <Condition>lessthan</Condition>
72
         <Value1>0.1</Value1>
                                         Critical
                                                    Copper to
73
         <ThicknessRule id="base">
                                          Trace
                                                     Copper
74
            <Condition>between</Conditi
                                          Width
75
           <Value1>0.035</Value1>
76
           <Value2>0.070</Value1>
                                              mm
                                                          mm
77
         </ThicknessRule>
                                            >0.40
                                                         0.23
78
       </FormattingRule>
79
        <FormattingRule id="minimumtrack">
80
          <Condition>lessthan</Condition>
          <Value1>0.125</Value1>
81
82
         <ThicknessRule id="base">
           <Condition>greaterthan</Condition>
83
84
           <Value1>0.070</Value1>
85
         </ThicknessRule>
86
       </FormattingRule>
```

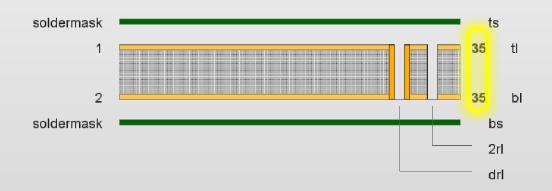
### Epaisseurs de cuivre



#### QED avec épaisseur de cuivre de base et fini par couche

- Information d'épaisseurs de cuivre avec d'autres paramètres peut être mis dans le fichier gbrjob par exemple, ajoutez-le dans l'archive à analyser par integr8tor
- Simple, facile et efficace ...

(Ajout au rapport QED PDF)



Files - Original						
Initial	Renamed	Function	Position	Color	Thic	kness
					Base	Finished

## **Enregistrement temps passé**



#### Enregistrement du temps interactif passé sur un dossier

- Affichez le temps passé en interactif sur un dossier pendant une session
   'To Ucam'
- Identifiez les données nécessitant systématiquement une intervention manuelle pour pouvoir donner des conseils sur les bonnes pratiques pour avoir des données standards.

(Ajout à Cockpit)

Original Data	Interactive Time
CDIpinv1.40vp (ID 18941).zip	01:21
107665.zip	00:00
107470.zip	00:00
107154.zip	00:00
107084.zip	
106488.zip	01:17
106046.zip	00:00
105847.zip	00:00
105832.zip	00:00

### **Utilisateur Cockpit**



#### **Auto log-off**

- Termine automatiquement les sessions Cockpit qui sont inactives ou périmées par exemple après une coupure sur le réseau.
- Ne plus être à court de licence Cockpit lorsque des utilisateurs oublient de fermer leur session.

(Ajout à Cockpit)



# Panneau d'assemblage



#### Analyse de la longueur de détourage

- Le détourage sur un panneau d'assemblage peut impacter considérablement le coût et les délais de livraison.
- Le nouveau champ QED « Depanel Rout Length » permet d'anticiper ce surcoût/délais.

(Ajout à Auto Analysis et rapport QED PDF)

	mm x mm mm mm	THE PROPERTY AND ADDRESS.		Y Spacing	Spacing	Bottom Border	Top Border	Right Border	Left Border	Panel Size	Original Image
Single PCB 178.021 x 143.000 15.000 5.000 5.000 3.000 3 x 2 1914.12	Single PCB 178.021 x 143.000 15.000 5.000 5.000 3.000 3 x 2	mn		mm	mm				mm	mm x mm	
		1914.126	3 x 2	3.000	5.000				15.000	178.021 x 143.000	Single PCB

## Vernis épargne



#### Ajout de nouvelles surfaces de finition et couleur de vernis

 Ajout de nouvelles surfaces de finitions et couleur de vernis conformément à ce qui existe en production

(Ajout à Cockpit, Email Input Integration, Web Input Integration, Hotfolder Input Integration)

### Extension de l'analyse du vernis épargne dans le QED

• Une analyse approfondie par face sur les ouvertures dans le vernis épargne sur les vias. Permet d'éviter les mauvaises surprises en production.

(Ajout à Auto Analysis et rapport QED PDF)

### QED PDF



No Side

Covered

Vias ①

Through-hole vias that are either(partially) covered by soldermask on the top layer and (partially) free on the bottom layer or (partially) free

#### **Annotation QED PDF**

Nouveau style du rapport QED PDF avec info-

(Ajout au rapport QED PDF)

bulles pour faciliter la lecture des informations	No	on the top layer and (	partially) covered on the bottom layer.	
du rapport.				
(A:+ a a OFD DDF)				

Partly

Covered

Via Holes

One Side

Covered

Vias 1

Both Sides

Covered

Vias 1

#### **Changement dans QED PDF Summary**

Le tableau résumant les données essentielles sur le circuit a été optimisé.

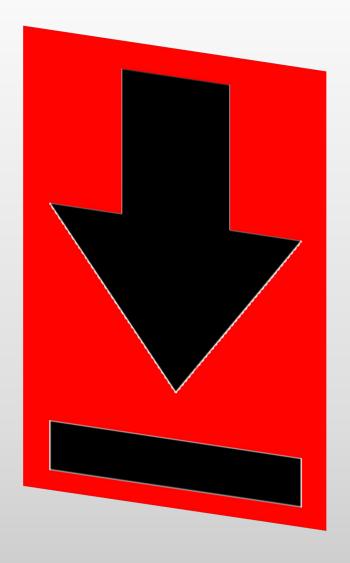
(Ajout au rapport QED PDF)

PCB Size	95 mm x 103.5 mm	Customer Panel Size	
PCB Thickness	1.6 mm	Max. Aspect Ratio on PTH	8.0
Copper Layers	6	Pressing Stages	1
Surface Finish	unknown	Drill Hole Density	2101 Holes/dm <sup>2</sup>
Solder Mask	Both	Testable Points	1508
Solder Mask Color	unknown	Min, SMD/BGA Size	0.28 mm
Legend	No	Via in Pad	No
Legend Color		Stacked Vias	No
Edge Connector Area	0 dm <sup>2</sup>	Castellated	No
Peeloff Mask	No	Anomalies	No
Carbon Mask	No		

### Installez v2020.12



- L'installeur peut être téléchargé sur ftp://ftp.ucamco.com/Integr8tor
- Nous vous conseillons d'installer cette mise à jour dès que possible
- Si vous avez besoin d'informations complémentaires, veuillez contacter notre partenaire commercial local ou la Hotline d'Ucamco
- Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Ucamco



Déjà tourné vers l'avenir



#### © Copyright 2021 Ucamco NV, Gent, Belgium. All rights reserved.

This material, information and instructions for use contained herein are the property of Ucamco NV. The material, information and instructions are provided on an AS IS basis without warranty of any kind.

Ucamco NV does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use, or the results of the use of the software or the information contained herein.

Ucamco NV shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use the software or the information contained herein.

The information contained herein is subject to change without prior notice.

Revisions may be issued from time to time to advise of such changes and/or additions.

No part of this presentation may be reproduced, stored in a data base or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from Ucamco NV.